



Laca protectora para soldadura

KONTAKT CHEMIE Flux SK 10

Descripción:

Solución tipo laca en base a resinas naturales sin aditivos. Tipo F-SW31, DIN 8511 T2

Propiedades generales y aplicaciones:

KONTAKT CHEMIE Flux SK 10 forma una película protectora, transparente. Protege los metales blandos para soldar (ej: cobre, acero, plomo, estaño, latón) contra la corrosión. Mantiene la soldadura, para realizar una soldadura posterior no es necesario eliminar la película protectora. Esta asegura un buen flujo de soldadura.

KONTAKT CHEMIE Flux SK 10 se utiliza, por ej., en el almacenamiento de tarjetas de circuito impreso y material que vaya a ser soldado, como terminales de soldadura o conductores. Se utiliza para mantener la soldabilidad de las piezas de plomo y componentes semiacabados fabricados con metales duros no ferrosos.

Datos técnicos

Aerosol		
Punto de inflamación		< 0 °C
Densidad a 20 °C	FEA 605	0.820 g/cm ³
Cubrición para espesor de 15 µm	calculado	0.7 m ² / 200 ml can
Granel		
Punto de inflamación	DIN 51 755	< 0 °C
Densidad a 20 °C	ASTM D 891	0.81 g/cm ³
Cubrición para espesor de 15 µm	calculado	4.7 m ² / l



Propiedades de la película seca		
Tipo de fundente	DIN 8511 T2	F-SW31
Color		Transparente, amarillento
Tiempo de secado	Método interno	30 min
Rango de T ^a	Método interno	0 °C to 60 °C

Instrucciones de aplicación:

Para **series cortas de fabricación o aplicaciones de mantenimiento**, es mejor utilizar KONTAKT CHEMIE Flux SK 10 en aerosol. Al contrario que otros barnices, este aerosol va presurizado con Dióxido de Carbono. Con este producto, no es necesario realizar la limpieza de la válvula mediante la pulverización con el aerosol boca abajo!

Para **grandes series de fabricación o aplicaciones**, KONTAKT CHEMIE Flux SK 10 puede aplicarse en granel utilizando una brocha, por inmersión o con pulverizador. En el caso de hacerlo por inmersión, debe determinarse el tiempo de inmersión y la velocidad de extracción. A menor tiempo de inmersión, menor espesor de la película.

KONTAKT CHEMIE Flux SK 10 se utiliza como protector temporal y para mantener la soldabilidad de metales blandos. La resina utilizada, protege contra la corrosión en ambientes secos y previene la acumulación de polvo, suciedad y huellas dactilares. También se suele utilizar el barniz como protector para PCB's que sean utilizados en ambientes secos. En ambientes muy húmedos, sin embargo, el barniz sufre una hidrólisis lenta que como resultado, disminuye las propiedades de protección y propiedades eléctricas. Para estos casos recomendamos utilizar el protector de tarjetas de circuitos impresos KONTAKT CHEMIE Plastik 70, KONTAKT CHEMIE Urethane 71 o KONTAKT CHEMIE Silisol 73.

Si debe aplicarse la protección después de el proceso de soldadura, el barniz soldable debe eliminarse. Lo más adecuado es utilizar limpiadores base alcohol, ethers glycol o hidrocarburos como KONTAKT CHEMIE Label Off 50. Para un pequeño número de piezas, lo más recomendable es utilizar KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC.

Cuando se utilice KONTAKT CHEMIE Flux SK 10 debe asegurarse una zona de trabajo bien ventilada. Las instalaciones deben ser apropiadas para la utilización de barnices con disolventes inflamables. Para mayor información, consultar las Hojas de Seguridad e Higiene.

Envasado

Aerosol : 200 ml, 400 ml
Granel : 1 L, 5 L

Estos valores no deben utilizarse como especificaciones. Esta información está basada en experiencias fiables. Es responsabilidad del usuario el determinar la idoneidad del producto.